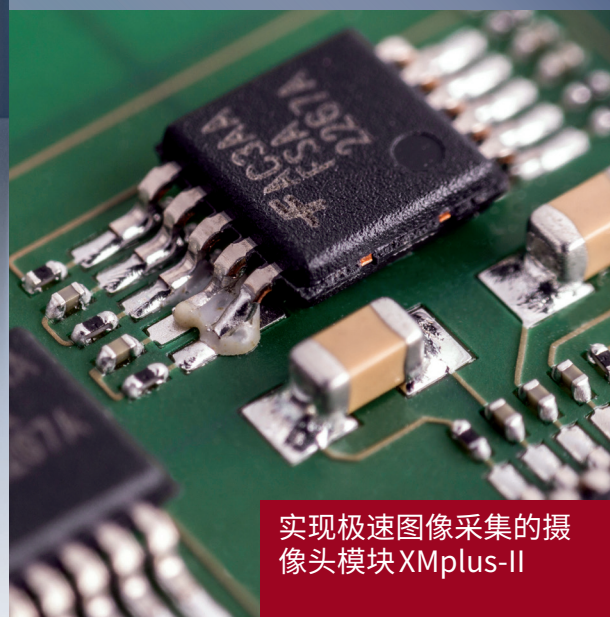




出色的3D计算
能力,可靠的
测量精准度



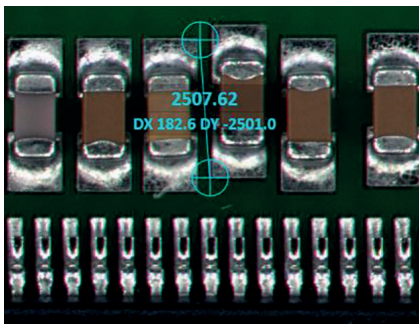
实现极速图像采集的摄
像头模块XMplus-II

iS6059 PCB Inspection Plus

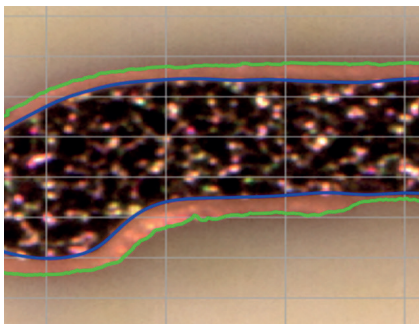
智能联网的自动光学
复杂元件组检测

3D AOI

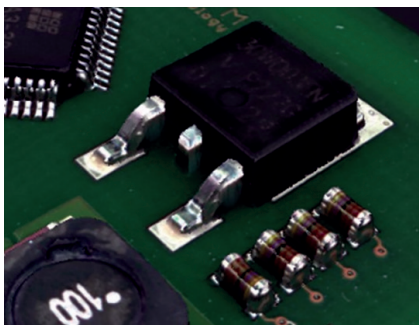
最高标准的生产线集成 质量控制能力



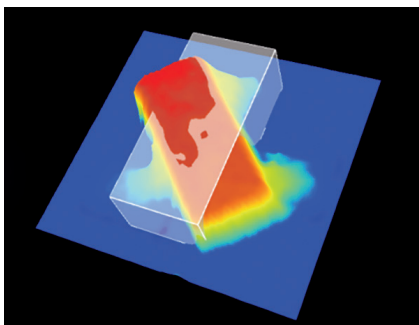
无论标准状态或突发状况，
都可轻松执行测量



结合 2D、2½D 和 3D 手段检测
Cut Void (切割间隙)



使用 360View 完成验证任务的渲染



使用 3D 方法查找元件主体

得益于最先进的传感系统, 成像效果极佳

高分辨率, 精确检测微小部件

大斜角视图, 实现最精准的分析

智能验证, 并可选配接入 AI 技术

操作和创建检测程序直观简易

流畅的数据处理, 性能强大的帧采集器

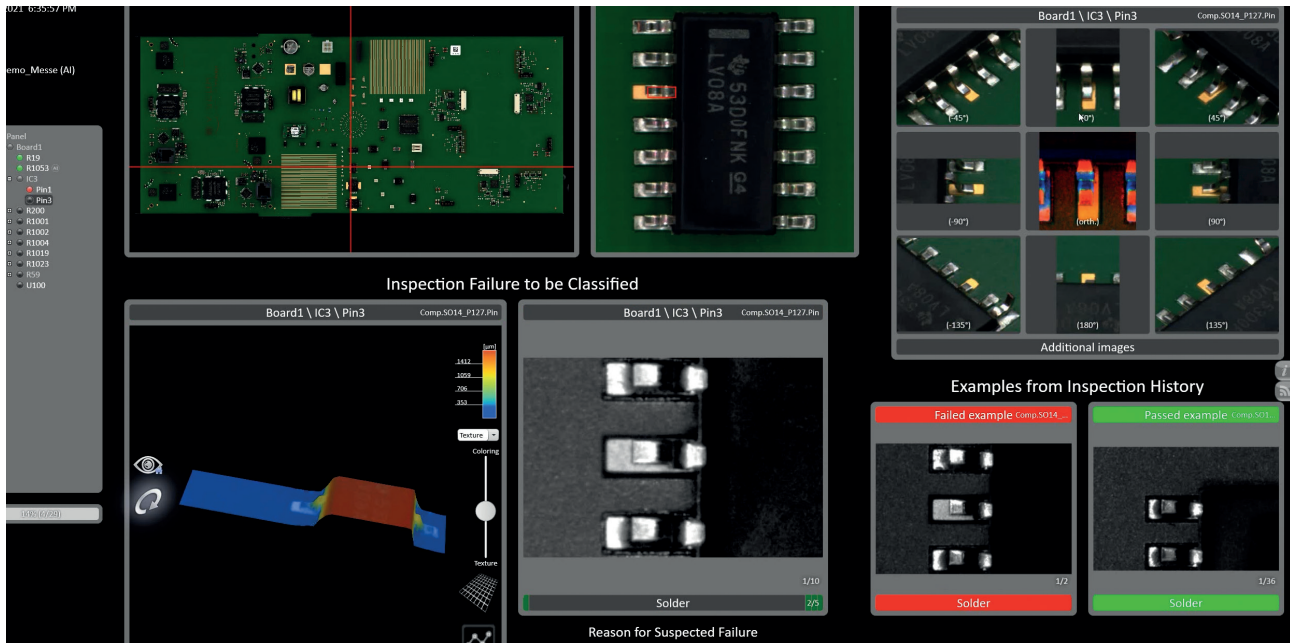
超高速处理检测对象

在全球范围提供优质、专业的服务, 包括在线、电话和现场

电子产品必须能够可靠运行, 并且通常满足极高的安全要求。品质和使用寿命是关键因素。在此背景下。出色的自动光学检测系统需要具备一流的 3D 和软件功能、测量高精度、卓越的图像质量, 以及十分稳定坚固的构造设计。

设备必须可满足众多客户和不同市场的需求, 因此, 简单易懂的编程和灵活便捷的操作是必不可少的。检测系统还须能灵活根据不同产品和不同产量, 对生产流程中可能出现的产品缺陷进行快速、无遗漏地识别。

针对大批量生产, 产量则更显重要。Viscom 在全新检测设备的研发阶段, 就对这些关键要素进行了周全的考虑。



使用 Viscom 的 vVerify 软件对测试结果进行分类

随着自动光学检测技术的不断向前发展,图像质量、结果评估以及用于优化生产流程的检测数据联网技术也不断进步。

自2013年起, Viscom就在其自动光学系统中引入3D技术, 一路发展至今已经成为了全球标准。硬件、算法和应用选项持续满足不断提升的行业要求。iS6059 PCB Inspection Plus 总共9个视角, 结合独立的内置可编程投影仪, 可为即使是最微小的部件创建完整全面的3D视图, 并执行精准的高度测量。

针对摄像头模块XMplus-II, Viscom的研发人员实现了倾斜视野的最大化, 以及在各个视角上更进一步立体景深, 从而实现较高组件上的字符识别。

凭借 VEG 105 帧采集器和超高速照明技术, 硬件加速 3D 逆算法达到了前所未有的性能水平, 在满足检测时间的最高要求的同时, 也能获得最佳图像质量和重复精准性。电路板更换可在短短几秒钟内完成。

Viscom 很早开始就将 3D 技术应用于电子元件快速探测或精确测量组件高度。另外，3D 焊锡连接点检测功能也在当今发挥着重要作用，和 Viscom 的 iS6059 PCB Inspection Plus 一样提供同水平的稳定功能。先进的检测方法可对微电子部件焊接点的正常与否进行快速全面的全自动检查，而人工智能 (vAI) 也可被集成于检测程序创建以及验证任务的各个不同阶段。

摄像头模块XMplus-II可权衡速度和图像质量并据此提供合适的照明选项。和Viscom早期推出的产品一样,新系统仍可按照需求结合常用的2D、2½D、和3D方法使用。例如,可以使用2D选项快速检测极性是否正确。

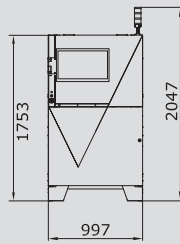
使用3D-SPI、3D-AOI、3D-AXI和3D-MXI获得的结果可进行智能组合,以实现全面联网质量控制。除此之外,iS6059 PCB Inspection Plus还可根据焊膏检测的指示在指定的位置全自动拍摄更多的照片。它还集成了如IPC HERMES 9852或IPC CFX等解决方案。

使用3D-AOI系统 iS6059 PCB Inspection Plus能显著改善流程, 避免生产不合格的报废件。从长远利益来看, 可降低制造成本并为高要求电子产品提供质量保证。

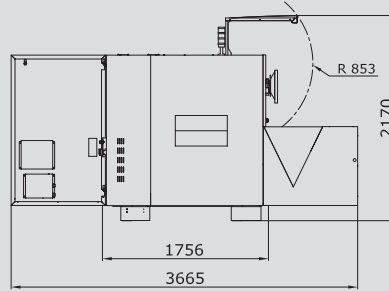
技术数据



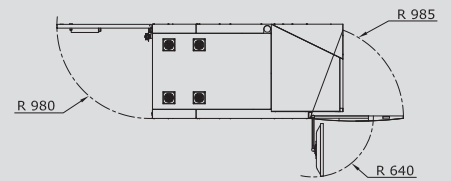
正面视图



侧视图



俯视图



单位:mm

iS6059 PCB Inspection Plus		
检测范围		焊点、组装、多件检查、字符识别、焊膏、形状、装配
传感技术		XMplus-II
	百万像素总数量	最高达 150
	3D 传感器	
	Z 分辨率	0.5 µm
	Z 测量范围	最大 30 mm
	斜角相机	
	百万像素摄像头数量	8
	直角相机	
	分辨率	10 µm
	视野范围	50 mm x 50 mm
检测速度		最高可达 80 cm ² /s
软件	操作界面	Viscom vVision/Sl EasyPro
	统计进程控制	Viscom vSPC/SPC, 开放式接口 (选配)
	验证维修站	Viscom vVerify/HARAN
	远程诊断	Viscom SRC (选配)
	编程站	Viscom PST34 (选配)
系统计算机	操作系统	Windows®
	处理器	Intel®Core™i9
印刷电路板处理	印刷电路板尺寸	508 mm x 508 mm; 提供长板选项
	电路板支架	选配
	传送高度	850 – 950 mm ± 20 mm
	宽度调整	自动
	输送方案	单轨传输; 双轨可选
	夹板方式	气动
	上方的通行高度	50 mm
其他系统数据	下方的通行高度	50 mm (其他高度敬请咨询)
	行走/定位单元	同步直线电机
	接口	SMEMA, SV70, Hermes, CFX, 第三方供应商
	能源要求	400 V, 50 Hz, 3P/N/PE +/- 10 %, 平均耗电量1.1 kWh, 4 – 6 bar 工作气压
	设备尺寸	997 mm x 1756 mm x 1753 mm (宽 x 长 x 高)
	重量	Ca. 1000 – 1080 kg

规格和其它系统信息如有变更, 恕不另行通知。详情以订购时的信息为准, 可能与此处所述有所不同。

我们的国际分部和代表处请查询网站: